

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2025-04-017

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 2024 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,689,599,079<sup>1</sup>为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	陈小曼、陈卓璜	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	
传真	0755-26613189	0755-26613189	
电话	0755-26634452	0755-26062342	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

<sup>1</sup>因公司 2020 年 7 月 23 日发行“兴森转债”可转换公司债券，目前处于转股期，公司股本总数可能发生变动，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数扣除公司回购证券账户中的股数为基数。

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“助力电子科技持续创新”的使命，确立了“全球先进电子电路方案数字制造领军者”的全新愿景，明确了“顾客为先、高效可靠、持续创新、共同成长”的核心价值观，确立了“用芯连接数字世界”的全新品牌主张。公司主营业务聚焦于“先进电子电路”和“数字制造”两大战略方向，经过 31 年的持续深耕与发展，公司具备覆盖先进电子电路全类别产品的技术能力，基于 Tenting 减成法、Msap 改良半加成法和 SAP 半加成法工艺的持续精进，涵盖传统高多层 PCB 板、软硬结合板、高密度互连 HDI 板、类载板（SLP）、ATE 半导体测试板、封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）等全类别产品，可为客户提供研发—设计—制造—SMT 贴装的一站式服务。在数字制造领域，基于厘清设计标准和制造能力的底层逻辑构建能力模型，确保生产过程精准有效控制、缩短新产品导入周期；基于知识库沉淀可制造性经验，通过协同设计服务和工程一体化服务平台助力客户在设计端提质、降本、增效，并通过平台完成参数提取、图形优化、结果检查、生产指示和控制要求输出、以及返回执行结果实现规则迭代；基于 PDCA 循环实现设计标准—制造执行—质量监督环节的数字制造一体化协同闭环，通过标签识别、数据上传下达配合设备和自动化辅助机构确保执行到位，并通过过程参数和产品特性的采集支撑配方持续优化，闭环迭代。

基于“先进电子电路”战略，依托于全类别先进电子电路产品和业内领先的快速交付能力，提升客户满意度，全面加强与合作客户的合作深度与广度。

基于“数字制造”战略，在各事业部深入推进数字化转型并构建长期竞争力，最终达到提高产品质量、提升生产效率、降低生产成本的目的。

报告期内，公司专注于先进电子电路方案产业，围绕传统 PCB 业务和半导体业务两大主线开展。传统 PCB 业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装，深化推进 PCB 工厂的数字化变革，力图实现从工程设计—制造—供应链&物流等全流程数字化改造，持续提升客户满意度和经营效率；高阶 PCB 领域，完善 Anylayer HDI 板和类载板（SLP）业务布局，在坚守高端智能手机主赛道的基础上，全力拓展高端光模块、毫米波通信市场；半导体业务聚焦于 IC 封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）领域，立足于芯片封装测试环节的关键材料自主配套。公司产品广泛应用于通信设备、消费电子、工业控制、医疗电子、服务器、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。

公司日常生产以客户订单为基础，采用“以销定产”的经营模式，为客户研发、生产提供高效定制化的服务。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。其中：

PCB 业务采用 CAD 设计、制造、SMT 表面贴装和销售的一站式服务经营模式。

半导体业务包含 IC 封装基板和半导体测试板业务。IC 封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）采用研发、设计、生产、销售的经营模式，应用领域涵盖存储芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片、CPU、GPU、FPGA、ASIC 等。半导体测试板采用研发、设计、制造、表面贴装和销售的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装后测试的各流程，产品类型包括探针卡、测试负载板、老化板、转接板。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	13,668,277,183.53	14,935,398,718.36	-8.48%	11,896,024,575.74
归属于上市公司股东的净资产	4,935,486,892.13	5,333,940,140.88	-7.47%	6,538,557,557.62
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	5,817,324,197.22	5,359,923,893.28	8.53%	5,353,854,994.29
归属于上市公司股东的净	-198,289,785.26	211,212,047.25	-193.88%	525,633,105.29

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,768,453.58	47,763,493.83	-509.87%	395,499,812.73
经营活动产生的现金流量净额	375,814,830.73	125,467,202.79	199.53%	727,441,912.21
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.13	-192.31%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.13	-192.31%	0.33
加权平均净资产收益率	-3.90%	3.41%	-7.31%	10.78%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,388,466,963.69	1,492,626,114.94	1,470,396,547.99	1,465,834,570.60
归属于上市公司股东的净利润	24,822,701.22	-5,321,660.93	-51,103,115.83	-166,687,709.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,926,610.95	4,836,036.32	-42,336,220.38	-182,194,880.47
经营活动产生的现金流量净额	73,613,626.84	159,419,753.64	-103,755,170.80	246,536,621.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,552	183,282,414	质押	55,450,000	
晋宁	境内自然人	3.96%	66,902,828	0	不适用	0	
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996	0	不适用	0	
张丽冰	境内自然人	2.39%	40,350,000	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	23,934,910	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	22,480,225	0	不适用	0	
金宇星	境内自然人	1.15%	19,416,161	0	不适用	0	

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.84%	14,165,074	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.76%	12,794,616	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	12,645,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东金宇星通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,946,300 股，通过普通证券账户持有公司股份 469,861 股，合计持有公司股份 19,416,161 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

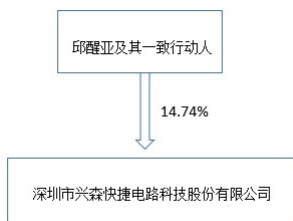
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券	兴森转债	128122	2020 年 07 月 23 日	2025 年 07 月 22 日	26,782.54	1.50% <sup>2</sup>
报告期内公司债券的付息兑付情况	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券（可转债简称：兴森转债，可转债代码：128122），每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。公司已于 2024 年 7 月 23 日向本次付息的债权登记日 2024 年 7 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者派发利息，可转债					

<sup>2</sup>可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%

票面利率 1.50%。

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司发行的可转债进行了信用评级，2024 年 6 月 25 日出具《2020 年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【196】号 01），公司主体信用等级维持为 AA，“兴森转债”的债券信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	59.20%	57.77%	1.43%
扣除非经常性损益后净利润	-19,576.85	4,776.35	-509.87%
EBITDA 全部债务比	4.52%	11.85%	-7.33%
利息保障倍数	-2.35	1.17	-300.85%

## 三、重要事项

### 1、部分募投项目延期

2024 年 1 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“宜兴硅谷印刷电路板二期工程项目”主要生产 PCB 多层板，投产后将新增 8 万平方米/月的 PCB 产能。本项目采用边建设边投产的方式，无需新建厂房，原计划工程建设期为 3 年，达产期为 T+5 年，预计于 2023 年建设完成，2025 年达产。在实施过程中，PCB 行业受宏观经济环境影响导致需求不振、竞争加剧、增长不达预期，宜兴硅谷根据市场环境及行业发展的变化，保持审慎态度，放缓了项目的实施进度，建设进度较原计划有所延迟。

为保障募投项目稳步实施，进一步提高募集资金使用效率，根据市场、行业环境变化及公司实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意将募投项目“宜兴硅谷印刷电路板二期工程项目”建设期延期至 2025 年。公司将结合 PCB 市场发展趋势及公司实际经营情况，动态调整项目建设进程。

### 2、回购公司股份

2024 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的债券（公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项），以完善公司长效激励与约束机制、降低公司负债及财务压力，提升公司整体价值，保障公司稳定、健康、可持续发展。回购股份价格不超过 16.84 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含)，回购资金来源为公司自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

2024 年 2 月 28 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,400,000 股，占公司当时总股本的 0.14%，最高成交价为 13.03 元/股，最低成交价为 12.65 元/股，支付的总金额为 31,108,487.50 元（含交易费用）。公司本次回购股份事项已实施完毕。

### 3、变更部分募集资金用途

2024 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司募投项目“宜兴硅谷印刷电路板二期工程项目”（以下简称“原募投项目”）主要生产 PCB 多层板，投产后将新增 8 万平方米/月的印刷电路板产能。鉴于目前 PCB 行业面临需求不振、竞争加剧、增长不达预期的现状，公司经审慎研究，

认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，同意公司放缓原募投项目投资节奏，并将尚未投入的 29,500 万元募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司 24% 股权。截至本报告披露日，广州兴科半导体有限公司 24% 股权项目正持续推进中。

#### 4、与专业投资机构共同投资基金

公司与深圳市国能金汇资产管理有限公司、李旭强、程江波共同签署了《共青城国能同芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人以自筹资金认缴人民币 1,090 万元参与设立共青城国能同芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国能同芯”），占认缴出资额的 47.5983%。国能同芯已于 2024 年 4 月募集完成，募集到位资金合计 2,290 万元人民币，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。截至本报告披露日，国能同芯已根据合伙协议的约定完成了向成都本原聚能科技有限公司（以下简称“成都本原”）的增资，以 2,101 万元增资款认购成都本原 2.4967% 股权，成都本原已办理注册资本、股东、公司章程等相关工商变更登记手续。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日